

期刊	封面特寫	趨勢與分析				設計與技術			
		產業前沿	高峰觀點*	工程師社群*	EDN 評論	技術縱橫	設計實例	設計解析	設計新視野
1 月刊 廣告預訂截止日期：11 月 27 日	智慧醫療	•		•	•	儲存技術	嵌入式設計		
2 月刊 廣告預訂截止日期：12 月 27 日	智慧連網車輛	•	•	•	•		導航技術	•	處理器/MCU
3 月刊 廣告預訂截止日期：1 月 25 日	5G/無線通訊	•		•	•	AR/VR	射頻/微波		
4 月刊 廣告預訂截止日期：2 月 27 日	無人機/機器人	•	•	•	•		可穿戴設計	•	電源管理
5 月刊 廣告預訂截止日期：3 月 27 日	智慧工廠	•		•	•	3D 掃描/列印	資料中心/雲端運算		
6 月刊 廣告預訂截止日期：4 月 26 日	電源管理/電池管理	•	•	•	•		電路保護	•	記憶體
7 月刊 廣告預訂截止日期：5 月 27 日	新能源	•		•	•	自動化測試	功率半導體		
8 月刊 廣告預訂截止日期：6 月 27 日	光達/毫米波雷達	•	•	•	•		類比/混合電路設計	•	訊號處理/資料轉換
9 月刊 廣告預訂截止日期：7 月 26 日	開源硬體/架構	•		•	•	生物識別	高速有線通訊		
10 月刊 廣告預訂截止日期：8 月 27 日	人工智慧/機器視覺	•	•	•	•		音視訊/影像處理	•	離散元件
11 月刊 廣告預訂截止日期：9 月 27 日	智慧城市	•		•	•	智慧家庭	光電/顯示		
12 月刊 廣告預訂截止日期：10 月 28 日	新材料/新製程	•	•	•	•		EDA/IC 設計	•	PCB 設計

*僅限中國大陸版

編輯查詢

有關台灣版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Judith Cheng (Judith.Cheng@aspencore.com) 聯繫。
有關中國大陸版的編輯及其他相關事項查詢，請與 Echo Zhao (Echo.Zhao@aspencore.com) 聯繫。

注：發行人保留對以上文章刪除及改動的權利。